耐高温柔性 PI 气凝胶的合成与性能

沈登雄1 房光强2 刘金刚1 杨士勇1

(1 中国科学院化学研究所高技术材料实验室,北京 100190)(2 上海宇航系统工程研究所,上海 201108)

文摘以3,3',4,4'-联苯四酸二酐(BPDA)和含咪唑环的芳香族二胺,2-(4-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑(4-APBI)或2-(3-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑(3-APBI)为聚合单体,以八(氨基苯基)聚倍半硅氧烷(OAPS)为交联剂,采用超临界CO₂干燥工艺制备了两种PI气凝胶,PIA-1(BPDA/4-APBI/OAPS)与PIA-2(BPDA/3-APBI/OAPS)。研究表明,制备的PI气凝胶具有纳米串珠状的微观结构,其泡孔最可几孔径分别为22 nm(PIA-1)与14 nm(PIA-2)。PIA-1与PIA-2的密度分别为0.105和0.080 g/cm³,BET表面积分别为693和302 m²/g。此外,制备的PI气凝胶具有良好的柔韧性与耐热稳定性,Tg超过了350℃,Td超过了530℃。
 关键词 PI气凝胶,笼形低聚倍半硅氧烷(POSS),超临界CO₂,合成

中图分类号:TQ323.7 DOI:10.3969/j.issn.1007-2330.2014.01.010

Synthesis and Properties of Flexible Polyimide Aerogels With High Thermal Resistance

SHEN Dengxiong¹ FANG Guangqiang² LIU Jingang¹ YANG Shiyong¹

Laboratory of Advanced Polymer Materials, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)
 (2 Institute of Shanghai Aerospace System Engineering, Shanghai 201108)

Abstract Two kinds of polyimide(PI) aerogels, PIA-1(BPDA/4-APBI/OAPS) and PIA-2(BPDA/3-AP-BI/OAPS) have been successfully prepared via the supercritical carbon dioxide drying process of the PI gels derived from 3,3',4,4'-biphenylene tetracarboxylic dianhydride(BPDA),2-(4-aminophenyl)-5-aminobenzimidazole(4-APBI) or 2-(3-aminophenyl)-5-aminobenzimidazole(3-APBI) and octa(aminophenyl) silsesquioxane(OAPS). The obtained PI aerogels exhibited micromorphology of a strain of beads with the pore size distribution peaks of 22 nm for PIA-1 and 14 nm for PIA-2. The densities of the PI aerogels are 0.105 g/cm³ for PIA-1 and 0.080 g/cm³ for PIA-2; and the Branuaer-Emmet-Teller (BET) surface areas of the aerogels are 693 m²/g and 302 m²/g, respectively. In addition, the PI aerogels exhibited good flexibility and thermal resistance with the T_g higher than 350°C and initial thermal decomposition temperatures over 530°C.

Key words Polyimide aerogel, Polyhedral oligomeric silsesquioxane, Supercritical carbon dioxide, Synthesis

0 引言

近 20 年来,气凝胶材料在航空、航天、微电子等高 科技领域中得到了越来越广泛的重视^[1-2]。无机气凝胶 (SiO₂ 等)具有优异的耐热稳定性(>1 000℃),但质脆、 易碎、力学性能相对较差,只能借助纤维布等材料进行 增强增韧;聚合物气凝胶轻质、柔性、易于加工使其应用 领域不断扩大。常见的聚合物气凝胶材料包括酚醛 (RF)、聚苯乙烯(PS)及聚酰亚胺(PI)气凝胶等。其中, PI 气凝胶的研究近年来颇受关注^[3]。2005 年后,NASA 等科研机构对 PI 气凝胶材料开展了系统的研究^[4-6]。 目前国外已经研制成功了具有耐高温、阻燃、高绝缘、高 绝热、低介电常数与介电损耗以及良好柔韧性的 PI 气

收稿日期:2013-10-30

作者简介:沈登雄,1986年出生,博士研究生,主要从事气凝胶结构与性能研究。E-mail:shendx@iccas.ac.cn

凝胶材料。这些材料在航空航天飞行器的防/隔热系统、飞行器液氢与液氧储罐、潜艇声阻隔系统、空间飞行器行星际进入一下降—着陆(EDL)系统、超声速充气气动减速器(HIAD)用热防护系统以及宇航服隔热等领域中均得到了系统评价,有望在不久的将来得到广泛应用。

国内在 PI 气凝胶领域内的研究尚处于起步阶段。本文对一类具有良好耐热稳定性的柔性 PI 气凝胶的合成工艺进行了研究,同时系统考察了单体结构、交联剂结构以及制备工艺对其性能的影响规律。

1 实验

1.1 原料与试剂

3,3',4,4'-联苯四酸二酐(BPDA),北京波米科 技有限公司,乙酸酐重结晶,180℃减压干燥10h。2 -(4-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑(4-APBI)、2-(3-氨基苯基)-5-氨基苯并咪唑(3-APBI)、八(氨基苯 基)聚倍半硅氧烷(OAPS),日本TCI公司。N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP),CaH₂回流,0.4 nm分子筛干燥。 其他试剂均为市售分析纯试剂。

1.2 测试表征

红外光谱(FT-IR)用 Perkin-Elmer 782 型傅里叶 变换红外光谱仪测定,采用衰减全反射方式(ATR),扫 描波数为4000~550 cm⁻¹。SEM 测试采用日立 S-4800 型扫描电子显微镜,样品表面喷 Pt 处理。气凝胶 的表面积与孔径分布采用 ASAP 2000 表面积与孔径分 布分析仪测定,所吸附的气体是 N₂,样品在测试前经 80℃真空脱气处理 10 h。表面积采用 BET 方法计算, 孔径分布采用 BJH 方法计算。PI 气凝胶的本体密度 (ρ_b)和骨架密度(ρ_s)采用美国麦克公司的 Auto Pore IV9520 压汞仪测得,孔隙率的计算见式(1)。

孔隙率=
$$\left(1-\frac{\rho_{\rm b}}{\rho_{\rm s}}\right)$$
×100% (1)

PI 气凝胶成型过程中的收缩率由式(2)计算。

收缩率=
$$\frac{D_{ee} - D_{fe}}{D_{ee}} \times 100\%$$
 (2)

式中,D模、D样分别为模具和样品的直径。

PI 气凝胶的压缩性能按照 ASTM—D695—10,在 Instron 3365 万能试验机上测试,牵伸速度为 2.5 mm/min,试样尺寸是 Φ15 mm×30 mm,压缩模量由应 力—应变曲线中初始线性形变阶段(10% 应变)的斜 率确定。压缩测试样品不少于 5 组,取平均值。TGA 采用美国 TA 公司 Q-50 热分析仪测定,升温速度为 20℃/min,测试环境为氮气氛。TMA 采用 TA 公司 Q400 分析仪,升温速度为 5℃/min,N₂ 气氛。

1.3 PI 气凝胶的合成

PIA 的合成路线如下:在一个配有机械搅拌、温度计、N₂ 入口的三口瓶中加入适量的 4-APBI 以及 新蒸馏的 NMP。通入 N₂,待 4-APBI 完全溶解后加 入过量的 BPDA 以及适量的 NMP,调整反应体系固 含量为 5wt%。反应 12 h 后得到黏稠的聚酰胺酸 (PAA)溶液。在体系中加入计量的 OAPS,继续反应 12 h 后,在反应体系中加入计量的乙酸酐与吡啶进 行亚胺化反应。搅拌 20 min 后将溶液浇注于模具 中,置于真空中脱泡,反应溶液在 2 h 内凝胶。将得 到的 PI 湿凝胶用乙醇反复交换除去 NMP。然后将 PI 湿凝胶置于超临界 CO₂ 干燥釜中,于 45℃,15 MPa 条件下干燥 6 h,得到气凝胶 PIA-1。

2 结果与讨论

2.1 PI 气凝胶的合成

研究表明^[7],湿凝胶超临界干燥过程中主要发 生收缩形变以及溶剂置换两个过程。收缩主要发生 在恒速干燥期,该干燥期主要变化是 PI 湿凝胶从固/ 液界面(PI/NMP 界面)转变为固/气界面(PI/CO₂)。 该转变是能量增加的阶段,气体在进入网络结构取代 液体时,气/液表面弯曲,产生毛细管张力。该毛细管 张力作用于液体使液体体积减少,从而使凝胶网络收 缩。如果凝胶网络是柔性的,张力就保持在很小的水 平。随着收缩量的增加,网络刚性增加,开始抵御毛 细管张力,当网络刚性足够大时,凝胶收缩就停止。 凝胶网络在干燥过程中的毛细管张力如果是均匀的, 网络将发生均匀收缩。因此,在超临界干燥过程中, 应选择适宜的条件,使 PI 凝胶中的液体溶剂被缓慢 地脱出,从而保证 PI 凝胶里的固体结构不会因为伴 随的毛细作用而被挤压破碎。

两种 PI 气凝胶的合成与制备路线如图 1 所示。 过量的 BPDA 二酐分别与两种含咪唑二胺 4-APBI 以及3-APBI反应首先在 NMP 中制得酐基封端的 PAA 溶液。然后加入 OAPS 交联剂反应制得 PAA 凝 胶。在 PAA 凝胶中加入乙酸酐/吡啶脱水剂即可制 得 PI 凝胶。将制得的 PI 凝胶经脱除 NMP 处理(乙 醇反复处理)后置于超临界 CO,反应釜中进行干燥, 即可制得最终的 PI 气凝胶。实际制备过程中,会产 生收缩。例如,线型 PI 气凝胶,如聚(均苯四甲酸二 酐-二氨基二苯醚,PMDA-ODA)在制备过程中的尺 寸收缩率可高达40%~80%^[8]。本文在制备 PI 过 程中采用了多官能团的 OAPS 进行交联反应,因此制 备的 PI 凝胶具有三维网络结构,这使得其在超临界 干燥过程中能够较好地抵抗由于毛细管力而造成的 收缩。表1给出了两种 PI 气凝胶制备过程中的收缩 率。可以看出,两种 PI 气凝胶的收缩率均<20%。

— 58 —



Fig. 1 Synthesis procedure of PI aerogels

表 1 PI 气凝胶的性能表征 Tab. 1 Properties of PI aerogels

PIA	收缩率 /%	孔隙率 /%	$ ho_{ m b}$ /g·cm ⁻³	表面积 /m ² ·g ⁻¹	T ⁵ d ∕°C	<i>T</i> _g ∕℃	压缩模量 /MPa	压缩强度(10% 应变)/MPa
PIA-1	17.7	92	0.105	693	553	364	18.65	0.25
PIA-2	14.2	72	0.080	302	533	360	2.29	0.19

PI 气凝胶的 ATR-FTIR 谱图如图 2 所示。



可以看出, 酰亚胺环位于1778 cm⁻¹(酰亚胺环 羰基不对称伸缩振动)、1722 cm⁻¹(酰亚胺环羰基对

称伸缩振动)、1 377 cm⁻¹(酰亚胺环 C—N 键伸缩振动)以及 736 cm⁻¹(酰亚胺环羰基面外弯曲振动)的特征吸收峰均可准确指认。同时, PAA 的酰胺键特征吸收峰(位于 3 500 cm⁻¹ 左右的酰胺键 N—H 伸缩振动峰以及位于 1 640 cm⁻¹ 左右的酰胺键羰基伸缩振动峰)在谱图中完全消失,表明 PI 亚胺化基本完全。

PI 气凝胶的 N₂ 吸附等温曲线与泡孔孔径分布 曲线如图 3 所示。可以看出,在相对压力超过 0.9 时,两种气凝胶样品的吸附体积均快速增大。而窄的 吸附-解吸附循环曲线表明在气凝胶中同时存在介 孔与大孔结构。泡孔孔径分布测试表明,PI 气凝胶 具有介孔/大孔结构,而且其泡孔孔径分布较宽,泡孔 最可几孔径分别为 22 nm(PIA-1) 与 14 nm(PIA-2)。

— 59 —



图 3 PI 气凝胶的 N, 吸附等温曲线与泡孔孔径分布曲线

Fig. 3 N_2 -sorption isothermals and pore size distributions plots (inserted) of PI aerogels

图 4 给出了两种 PI 气凝胶的 SEM 图像。可以 看出,两种 PI 气凝胶具有类似的微观结构,均呈现出



(a) PIA-1

纳米球串状,空气填充在纳米纤维与颗粒间。这种结构赋予了 PI 气凝胶很低的密度。



(b) PIA-2

图 4 PI 气凝胶的 SEM 图像

Fig. 4 SEM micrograph of PI aerogels

从表1可以看出,PIA-1的BET表面积较PIA-2高出一倍多。本文中,PIA-1采用了4-APBI单体, 其刚性要高于间位取代的3-APBI。而文献中报道, 刚性单体制备的PI气凝胶的收缩率一般要高于柔性 单体制备的。结构相对刚性的PIA-1的收缩率 (17.7%)高于PIA-2(14.2%),造成PIA-1的密度 高于PIA-2。PIA-2的孔隙率远低于PIA-1。这可 能是由于 PIA-2 湿凝胶在超临界干燥过程中由于其 分子结构的柔顺性相对较高,造成其网络结构抵御毛 细管力的作用下降,因此有可能部分地发生了坍塌或 发生贯通(图3),PIA-2 的孔径分布比 PIA-1 宽得 多,表明其内部结构中大孔结构的比例较高。

2.2 耐热性能

图 5 为 PI 气凝胶的 TGA 与 TMA 曲线。



图 5 PIA 的 TGA 和 TMA 曲线

Fig. 5 TGA curves and TMA curves of PI aerogels

由 TGA 曲线可以看出,制备的两种 PI 气凝胶在 400℃之前没有出现明显的热失重,表明其亚胺化反 应较为完全,而且 NMP 溶剂也基本去除干净。两种 PI 气凝胶均具有良好的热稳定性,其 T_d^6 值超过了 530℃。相比之下,结构更为刚性的 PIA-1 的 T_d^6 值 (553℃)较 PIA-2 高 20℃。PIA-1 在 750℃时的残 重率为 70.3%,较 PIA-2 高 4%。由图 6 所示的 TMA 曲线可以看出,两种 PIA 气凝胶在测试过程中 表现出了不同的尺寸变化行为。结构相对较为柔顺 的 PIA-2 在加热过程中,当温度超过 $T_g(360℃)$ 时明 显表现出了收缩行为,而 PIA-1 在加热过程中其尺 寸变化相对较小,只是在温度达到 $T_g(364℃)$ 以后, 其尺寸变化趋势才趋于明显,这与 PIA-1 结构较强 的刚性有关。



图 6 PI 气凝胶的应力-应变曲线

Fig. 6 Stress-strain plots of PI aerogels

2.3 压缩性能

制备的 PI 气凝胶表观上具有良好的柔韧性。两种 PI 气凝胶均可以进行弯折而不会发生断裂。由图 4 可以看出,相互贯通的纳米纤维结构可赋予 PI 气凝胶良好的压缩性能。图 6 给出了两种 PIA 气凝胶的应力—应变曲线。

从表1可以看出,PIA-1 在应变达到50%时发 生屈服,而PIA-2 在应变达到55%时仍未屈服。按 照应力—应变曲线的初始阶段(10%应变)测得的 PIA-1 的压缩强度与模量分别为0.25 和18.65 MPa,均高于PIA-2 的0.19 和2.29 MPa。PIA-1 的 密度高于PIA-2,因此表现出了更高的模量。本文制 备的 PI 气凝胶的压缩模量和强度与文献[6]报道的 基于 BPDA、4,4'-二氨基二苯醚(ODA)、2,2'-二甲 基-4,4'-二氨基联苯(DMBZ)以及 OAPS 的 PI 气凝 胶较为类似,但明显低于由更为刚性的对苯二胺 (PPDA)制备的 PI 气凝胶。

3 结论

采用 BPDA 分别与两种含咪唑二胺单体 4-APBI 和 3-APBI 以及多氨基 POSS 制备了两种 PI 气凝胶 PIA-1 和 PIA-2。研究表明,刚性的苯并咪唑环赋予 了气凝胶良好的耐热稳定性,*T_g* 超过了 350℃,*T⁶_d* 超 过了 530℃。同时,三维交联的分子结构赋予了 PI 气凝胶良好的压缩性能以及低收缩率。相比之下,采 用刚性 PIA-1 气凝胶较 PIA-2 气凝胶具有更为优异 的综合性能,其中孔隙率为 92%,BET 表面积为 693 m²/g,压缩模量为 18.6 MPa,10% 应变的压缩强度为 0.25 MPa。上述优良特性使得 PI 气凝胶在航空航天 防隔热领域有望具有良好的应用前景。

参考文献

[1] Pierre A C. History of aerogels // Aegerter M A, Leventis N, Koebel M(eds). Aerogels handbook[M]. Springer Science + Business Media: New York, 2011:3-18

[2] Jones S M. Aerogel: space exploration applications[J]. J Sol-Gel Sci. Technol. ,2006,40:351-357

[3] Guo H Q, Meador M A B, McCorkle L, et al. Polyimide aerogels cross-linked through amine functionalized polyoligomeric silsesquioxane [J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2011, 3:546-552

[4] Meador M A B, Malow E J, Silva R, et al. Mechanically strong, flexible polyimide aerogels cross-linked with aromatic triamine[J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2012, 4:536-544

[5] Guo H Q, Meador M A B, McCorkle L, et al. Tailoring properties of cross-linked polyimide aerogels for better moisture resistance, flexibility, and strength [J]. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4:5422–5429

[6] Meador M A B, Wright S, Sandberg A, et al. Low dielectric polyimide aerogels as substrates for lightweight patch antennas. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012,4:6346-6353

[7] Kistler S S. Coherent expanded aerogels and jellies[J]. Nature, 1931, 127:741

[8] Rhine W, Wang J, Begag R. Polyimide aerogels, carbon aerogels, and metal carbide aerogels and methods of making same [P]. US Patent 7074880,2006-7-11

(编辑 吴坚)